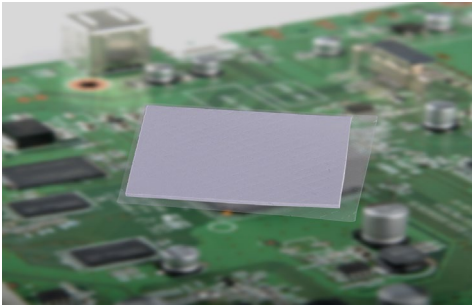


高柔软导热硅胶垫片

TP150-H55-S导热硅胶垫片是一款兼顾性能、操作性的一款产品，具有低热阻、高柔软、高浸润性和高顺从性的一款独特的导热垫片，在-40℃~150℃可以稳定工作。



特性和优点

- 导热系数1.5W/(m·K)
- 超柔软
- 双面自粘
- 高电气绝缘
- 玻纤/PI膜加强可选
- 低压缩力应用，具有高压缩比

典型应用

- 平面显示器
- 功率转换设备
- LCD背光模块
- 高速大存储驱动
- 汽车发动机控制单元
- 冷却器件到底盘或框架之间

典型属性			
属性		典型值	测试方法
颜色		浅灰色	目视
厚度(mm)		0.5~10.0	ASTM D374
密度(g/cc)		2.2	ASTM D792
硬度(Shore 00)		55~60(厚度≤1.0mm)	ASTM D2240
		50~55(厚度>1.0mm)	
渗油率	(Φ/mm)	≤40	初始直径Φ30mm 滤纸吸附@压缩25%/125℃/48h
	(%)	<0.5	
耐温范围(℃)		-40~150	/
防火性能		V-0	UL 94
保质期(月)		12	温度<40℃避免挤压、暴晒
电性能			
击穿电压(kV/mm)		≥10	ASTM D149
介电常数(@1MHz)		4.11	ASTM D150
体积电阻率(Ω·cm)		10 ¹³	ASTM D257
导热性能			
导热系数(W/(m·K))		1.5	ISO 22007-2